

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2023-029

深圳市民德电子科技股份有限公司

关于浙江广芯微电子有限公司项目预计投产通线的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）投资的浙江广芯微电子有限公司（以下简称“广芯微电子”）高端特色工艺半导体晶圆代工项目，预计将于 2023 年 5 月 19 日实现投产通线。

一、项目进展情况

公司致力于打造功率半导体的 smart IDM 生态圈，广芯微电子晶圆代工环节是整个生态圈中最为重要的环节。广芯微电子有限公司成立于 2021 年 10 月，项目在 2022 年 2 月土建动工打桩，5 月完成主体厂房封顶，12 月首台设备进场，在 2023 年 3 月成功合环供电。目前项目正处于最后的设备安装调试阶段，根据进度计划，预计将于 2023 年 5 月 19 日实现投产通线。

二、对公司的影响

广芯微电子项目的投产通线，将是公司功率半导体 smart IDM 生态圈构建过程中具有里程碑意义的关键一步，为生态圈内企业及早发挥协同效应、扩大公司经营规模、提升经营效率奠定基础，并助力公司实现在功率半导体业务方面的跨越式发展。

广芯微电子项目投产后，将彻底打开公司功率半导体产能扩张的天花板，为公司开拓更多高端特色新产品提供强有力的支撑，增强公司产业竞争力，拓展更广阔的市场空间，也将为公司 2021 年向特定对象发行股票募集资金投资项目的顺利实施提供有效保障。

三、项目风险提示

1、广芯微电子项目后续面临产品验证、市场营销等环节，以及团队扩建、

内部运营体系建设等任务，仍具有诸多挑战与不确定性。

2、参照晶圆代工厂建设及产能爬坡的客观要求，项目从投产通线到大规模量产，需要一定的时间，期间宏观政策环境的变动、行业竞争情况、供求关系的变化、技术水平更替等因素会对项目产生较大影响，导致项目实施进度、产品销售价格、原材料采购价格、客户需求情况等发生变化，从而对本项目的预期效益实现带来影响。

后续公司将密切关注项目进展情况，并将严格按照深圳证券交易所及公司相关规章制度要求，及时披露项目进展情况，也敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

深圳市民德电子科技股份有限公司董事会

2023年4月24日